

株主の皆さまへ

第 38 期 報 告 書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

TOWA





■ご挨拶

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
 このたびの熊本地方を中心に発生した地震で被災されました皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
 ここに、当社第38期報告書（2015年4月1日から2016年3月31日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。
 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢や所得環境の改善が続く中、政府や日銀による各種政策の効果もあり、緩やかな回復基調が続きました。欧米経済が堅調な個人消費に支えられ底堅く推移した一方、中国経済の減速を始めとするアジア新興国経済の停滞等により、海外経済の不確実性は高まっており、先行きの不透明感が払拭できない状況で推移いたしました。
 半導体業界におきましては、米国を中心にM&A（合併・買収）による大型再編が活発となり、特に中国では、世界トップクラスの半導体企業を自国内に育成するという国家戦略のもと、外国企業への投資や買収提案が積極的に行われました。半導体の需要としましては、短期的には牽引役であるパソコンやスマートフォン市場の成長鈍化の影響が見られ、一部の大手半導体メーカーが設備投資計画を下方修正する等、消極的な局面が現れたものの、中長期的には、車載関連の伸びやIoT（モノのインターネット化）の加速により継続成長が見込まれております。
 このような状況のもと当社グループでは、最先端の次世代半導体パッケージに対する顧客ニーズを捉えた装置開発と積極的な販売活動を展開し、受注を伸ばすことができました。
 当社は、株主の皆さまへの利益還元を重要な経営施策の一つと考えており、競争力のある製品開発を目指す研究開発投資や生産性向上を目的とする設備投資、新たな市場への事業展開に係る投資、また、財務体質の改善等に必要となる内部留保を確保した上で、各事業年度の業績に応じた利益配分を実施することを基本方針としております。
 この方針に基づき、当期につきましては、1株当たり10円の配当とさせていただきます。
 今後とも、株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、グループ一丸となって邁進していく所存でございますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2016年6月

代表取締役社長 **岡田博和**

最先端の次世代半導体パッケージのさらなる大判化・薄型化・小型化に伴い、顧客ニーズが多様化する中、当社は独自開発のコンプレッション方式を用いたPMC等のモールドディング装置を中心に積極的な販売活動を展開してまいりました。さらに、ファンアウト型ウエハーレベルパッケージ（FOWLP）等の最先端実装技術に対して、顆粒樹脂にも液状樹脂にも対応可能な「CPMシリーズ」を開発し市場に投入いたしました。

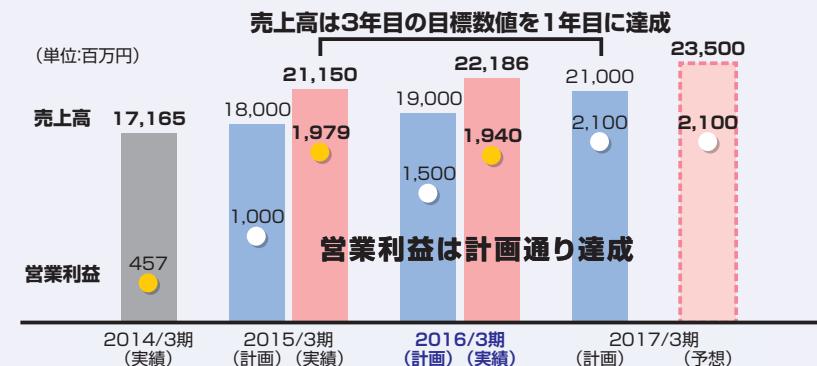
以上の結果、当連結会計年度における売上高は221億86百万円（前連結会計年度比10億36百万円、4.9%増）、営業利益19億40百万円（前連結会計年度比38百万円、1.9%減）、経常利益20億57百万円（前連結会計年度比2億39百万円、10.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益17億90百万円（前連結会計年度比1億43百万円、7.4%減）となりました。

今後も当社グループは、コンプレッション技術を武器に半導体モールドディング装置の市場伸張を図るとともに、新たな分野へコア技術の展開を進めてまいります。また、新事業による成長戦略の推進として、トータルソリューションサービス（TSS）事業の構築、超精密エンドミル等の消耗品ビジネスおよび高離型コーティング技術「バンセラ」の事業成長に取り組んでまいります。

変革への歩み出し—中期経営計画・TOWA10年ビジョン進捗

2014年、当社は既存事業の伸張とコア技術の応用展開、そして「新たな市場」創造によるポートフォリオ変革等を目指す長期経営ビジョン「TOWA10年ビジョン」を掲げ、その具現化へのマイルストーンとなる諸施策・戦略等を中期（3カ年）経営計画として取りまとめました。

中期経営計画（2014年度～2016年度）の2年目となる当期は、売上高において計画数値を上回り、営業利益につきましても計画達成いたしました。最終年度に向け、今後も力強く事業推進してまいります。



中期（3カ年）経営計画進捗状況

さらなる成長を目指して

コア技術
コンプレッション技術を活用した
新製品を開発



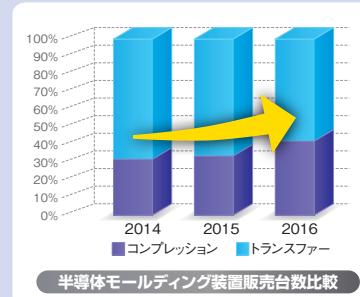
▲CPM1080

当社は、独自のコンプレッション技術を活用することにより、リードフレームや基板の大判化に対応でき、低コスト高生産性を実現する装置「CPM1080/1180」を開発いたしました。

半導体のパッケージ技術は、薄型化・高集積化への対応が求められており、従来のリードフレームや基板にチップを搭載して封止（モールド）するのではなく、基板等を省いてモールドするウエハーレベルパッケージ（WLP）が台頭してきております。

WLPは、すでに一部の半導体メーカーが液状樹脂を用いて生産している実績がありますが、当社が開発した装置は、さらに顆粒樹脂にも対応可能であります。

顆粒と液状、両方の樹脂に対応可能な当社の新製品と成形プロセスは、樹脂コストを大幅に低減できる上、成形時の反り対策にも優位性を発揮するとして大変期待されております。



応用展開
事業機会の創出



2015年10月、TOWA韓国株式会社が韓国最大の半導体製造装置メーカーであるSEMES社のモルディング事業を譲受いたしました。

今後はTOWA韓国天安事業所として、モルディング事業の売上伸張を図るとともに、TSS（トータルソリューションサービス）をはじめとしたサービスの強化と新たな市場創造に向け、成長戦略を積極的に進めてまいります。

新事業
新事業領域への展開

2014年の販売開始以来、高精度・長寿命・低価格で大変ご好評をいただいておりますTOWAオリジナル工具「THPL-CBNエンドミルシリーズ」に、ラッピングタイプ、多数刃など新たにラインナップを追加いたしました。

超精密金型製造をコア技術とする当社の工具が、様々なシーンでの面質向上や深彫加工を可能にし、お客様の多様なご要望に応じた高精度加工を実現しております。工具市場において、CBN工具は高硬度と加工効率の点から今後も伸びが期待されており、さらなる事業拡大を目指してまいります。



▲CBNラッピングボールエンドミル



▲右：標準品のみ
左：標準品+当社ラッピングボールエンドミル活用

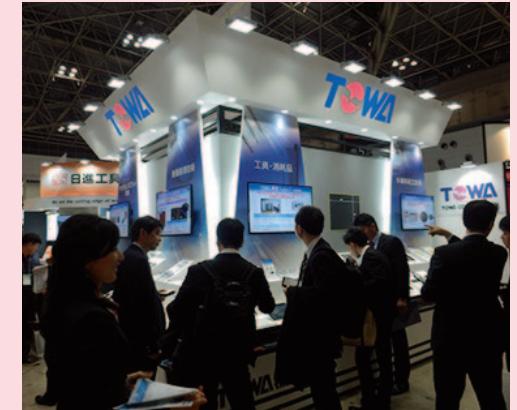
TOPICS
トピックス

ネプコンジャパン 出展

2016年1月13日から15日の3日間にわたり、東京ビッグサイトで開催されましたエレクトロニクス技術展「ネプコンジャパン2016」に出展いたしました。

TOWAのコア技術である微細加工技術をベースとした新技術をご提案し、超微細マイクロレンズアレイを用いた車載用ヘッドアップディスプレイの実演や「バンセラ」コーティングによる射出成形事例など、具体的なお提案とともに、次世代を担う製品の数々をご紹介しました。

当社ブースへは、過去最高を記録する多くのお客さまにご来場いただき、新事業ビジネスの拡大に向け、TOWAの技術をより多くのお客さまに、お伝えすることができました。



セミコンチャイナ 出展

2016年3月15日から17日の3日間に中国・上海で開催されました「セミコンチャイナ2016」に出展いたしました。

中国政府は付加価値の高いハイテク産業の発展を目標としており、世界に通用する半導体産業の育成に向け、国家戦略とし積極的に投資を行っています。

今回のセミコンチャイナも活況を呈しており、当社ブースにも多くのお客さまにご来場いただき、活発な情報交換が行われました。

また、当社技術に対し高い評価をいただくことができ、今後の拡販につながる貴重な機会となりました。

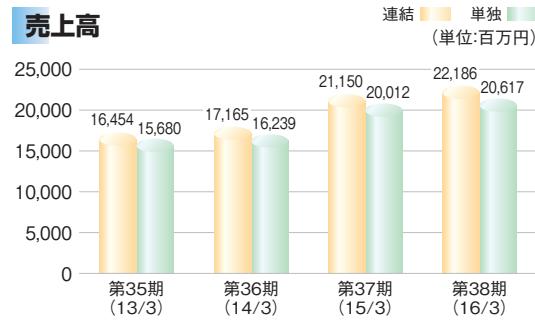


個人投資家向け会社説明会を開催

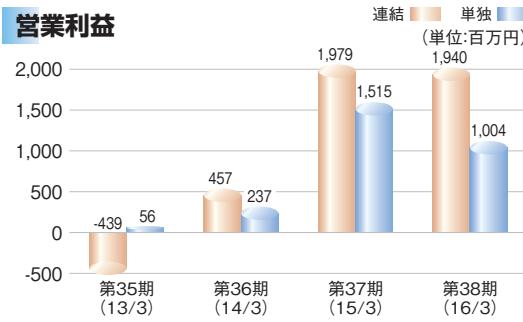
2015年12月に野村證券主催、2016年1月にSMBC日興証券主催での個人投資家向け会社説明会を開催いたしました。当社の事業内容や企業文化を感じていただけるよう、こうした説明会やセミナーをはじめ、今後も様々な活動を展開してまいります。

業績の推移

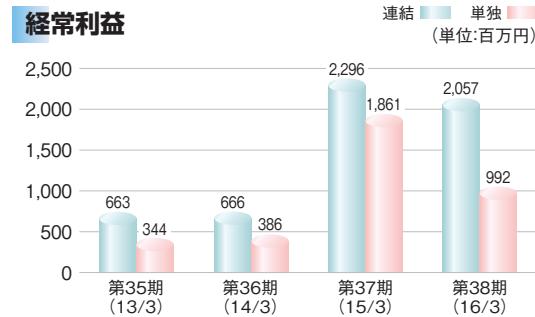
売上高



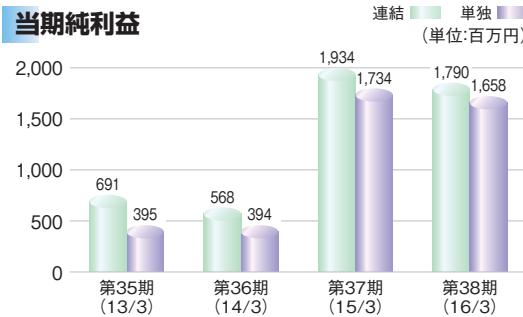
営業利益



経常利益

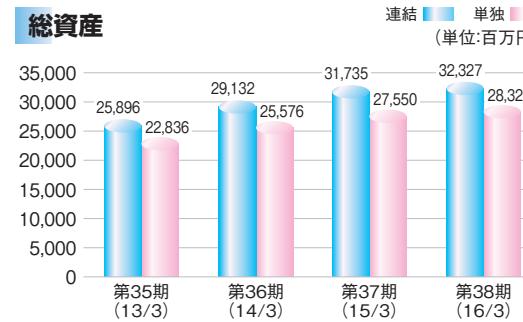


当期純利益

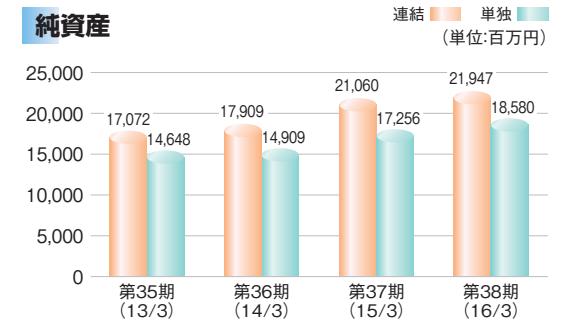


(注)連結については、親会社株主に帰属する当期純利益を記載しております。

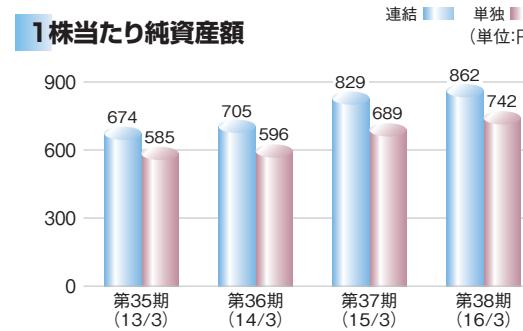
総資産



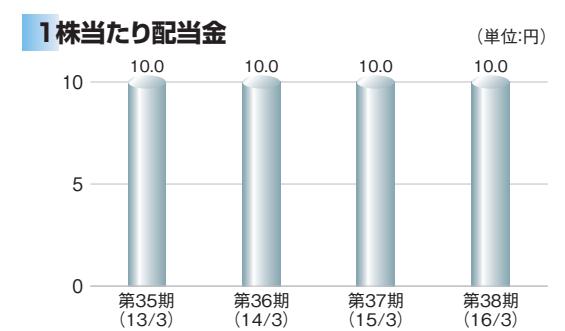
純資産



1株当たり純資産額

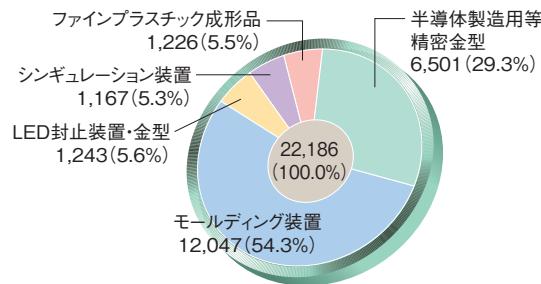


1株当たり配当金

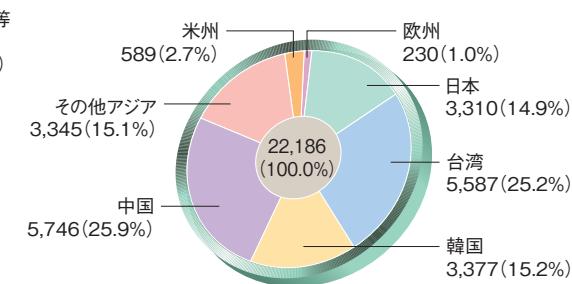


[セグメント別連結売上高(第38期)]

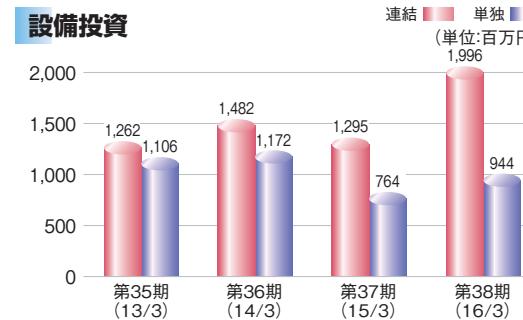
製品別 (単位:百万円)



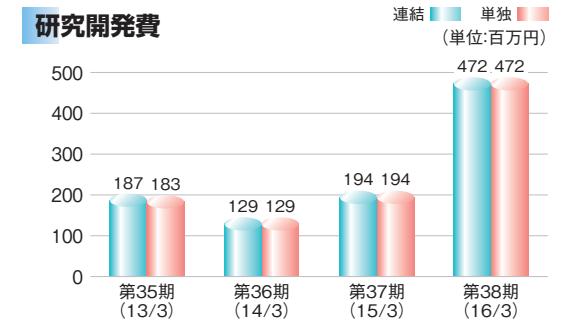
地域別 (単位:百万円)



設備投資



研究開発費



(注)当連結会計年度より会計方針の変更を行っているため、前期末(15/3)について遡及適用後の数値を記載しております。

決算概要

連結貸借対照表 (2016年3月31日現在)

科目	金額
【資産の部】	
流動資産	17,513
現金および預金	6,256
受取手形および売掛金	7,412
電子記録債権	23
たな卸資産	3,281
その他	541
固定資産	14,813
有形固定資産	11,497
建物および構築物	4,157
土地	4,476
その他	2,864
無形固定資産	696
投資その他の資産	2,619
資産合計	32,327

(注) 当期の連結子会社は 13社、持分法適用会社は 1社であります。

連結損益計算書

(2015年4月1日から2016年3月31日まで) (単位: 百万円)

科目	金額
売上高	22,186
売上原価	15,092
売上総利益	7,093
販売費および一般管理費	5,153
営業利益	1,940
営業外収益	204
営業外費用	88
経常利益	2,057
特別利益	165
特別損失	4
税金等調整前当期純利益	2,219
法人税・住民税および事業税	312
法人税等調整額	17
当期純利益	1,889
非支配株主に帰属する当期純利益	98
親会社株主に帰属する当期純利益	1,790

(単位: 百万円)

科目	金額
【負債および純資産の部】	
流動負債	6,738
支払手形および買掛金	2,847
短期借入金	270
一年以内返済予定長期借入金	1,387
その他	2,234
固定負債	3,640
長期借入金	2,860
その他	780
負債合計	10,379
株主資本	20,364
資本金	8,932
資本剰余金	462
利益剰余金	10,979
自己株式	△ 9
その他の包括利益累計額	1,215
その他有価証券評価差額金	939
為替換算調整勘定	287
退職給付に係る調整累計額	△ 11
非支配株主持分	367
純資産合計	21,947
負債・純資産合計	32,327

連結キャッシュ・フロー計算書

(2015年4月1日から2016年3月31日まで) (単位: 百万円)

科目	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,254
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,806
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 868
現金および現金同等物の期末残高	6,027

(注) 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」を「当期純利益」、「少数株主利益」を「非支配株主に帰属する当期純利益」、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。

連結株主資本等変動計算書 (2015年4月1日から2016年3月31日まで)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2015年4月1日 期首残高	8,932	462	9,409	△ 9	18,794
会計方針の変更による累積的影響額			29		29
会計方針の変更を反映した2015年4月1日 期首残高	8,932	462	9,438	△ 9	18,824
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△ 250		△ 250
親会社株主に帰属する当期純利益			1,790		1,790
自己株式の取得				△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	1,540	△ 0	1,540
2016年3月31日 期末残高	8,932	462	10,979	△ 9	20,364

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
2015年4月1日 期首残高	1,023	789	133	1,946	318	21,060
会計方針の変更による累積的影響額		△ 29		△ 29		0
会計方針の変更を反映した2015年4月1日 期首残高	1,023	760	133	1,917	318	21,060
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△ 250
親会社株主に帰属する当期純利益						1,790
自己株式の取得						△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△ 84	△ 473	△ 145	△ 702	48	△ 653
連結会計年度中の変動額合計	△ 84	△ 473	△ 145	△ 702	48	886
2016年3月31日 期末残高	939	287	△ 11	1,215	367	21,947

(注) 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、「少数株主持分」を「非支配株主持分」、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としてあり、前連結会計年度についても科目名を統一しております。

会社の概要

商号	TOWA株式会社 (英文名TOWA CORPORATION)		
設立	1979年4月17日		
資本金	8,932,627,777円		
本社所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地 ☎(075) 692-0250(代表)		
従業員数	453名		
役員	代表取締役社長	岡田博和	和二浩住
(2016年6月29日現在)	専務取締役	小西久	芳肇
	取締役常務執行役員	浦上	大輔
	取締役上席執行役員	田村吉	重篤
	取締役常勤監査等委員	小林久	二昇
	社外取締役監査等委員	桑木	
	社外取締役監査等委員	和氣	
	上席執行役員	石田耕	
	執行役員	蒲生喜代	
	執行役員	伊藤慎	
	執行役員	高瀬	
	執行役員	早坂	
ホームページ	http://www.towajapan.co.jp		
上場取引所	東京証券取引所市場第一部		

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
定時株主総会	毎年6月
基準日	株主総会権利行使および期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部
郵便物の郵送先及び 電話お問合せ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-288-324(フリーダイヤル)
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行 本店および全国各支店 みずほ銀行 本店および全国各支店 (みずほ証券では取次のみとなります)
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、 やむをえない事由により電子公告を することができない場合は、日本経済新 聞に掲載します。 公告掲載URL http://www.towajapan.co.jp

株式の状況 (2016年3月31日現在)

●発行可能株式総数	80,000,000株
●発行済株式の総数	25,021,832株
●株主数	7,065名
●大株主	

株主名	持株数	持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	3,368千株	13.47%
株式会社ケイビー恒産	2,000	8.00
蒲生徳子	1,398	5.59
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/ JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	1,230	4.92
資産管理サービス信託銀行株式会社	1,079	4.32
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1,031	4.13
株式会社京都銀行	699	2.80
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	695	2.78
JP MORGAN CHASE BANK 385181	610	2.44
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	548	2.19

(注1) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会社
および日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係るもの
です。

(注2) 持株比率は、自己株式(11,253株)を控除して計算しております。

TOWAグループ (2016年3月31日現在)

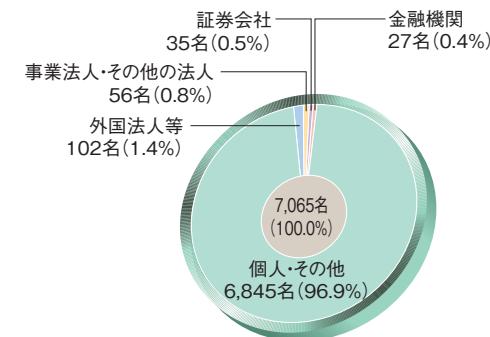
■国内

TOWA株式会社
本社・工場
京都東事業所
坂東記念研究所
九州事業所
東京営業所
株式会社バンディック
TOWATEC株式会社
株式会社サーク

■海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)
TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)
TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp. (フィリピン)
TOWA USA Corporation (米国)
TOWA Europe B.V. (オランダ)
東和半導体設備(上海)有限公司(中国)
上海沙迪克軟件有限公司(中国)
TOWA半導体設備(蘇州)有限公司(中国)
蘇州STK鑄造有限公司(中国)
台湾東和半導体設備股份有限公司(台湾)
巨東精技股份有限公司(台湾)
TOWA韓国株式会社(韓国)
株式会社東進(韓国)

■所有者別株主数分布



■所有者別株式数分布

